

2011年5月17日

日本電子材料株式会社 2010年度通期決算概況 2011年度～2013年度中期計画

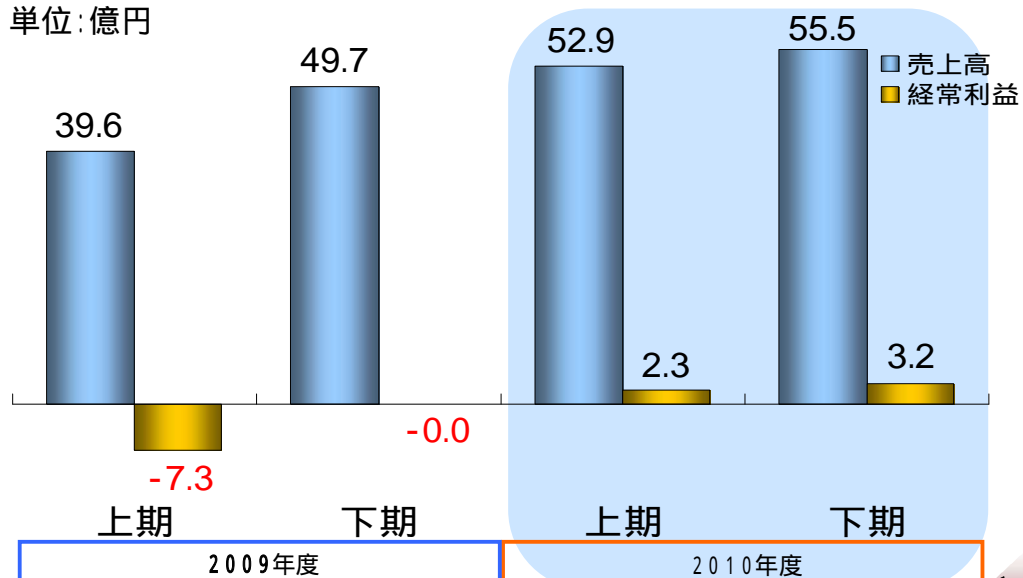
将来の見通しに関する記述についての注意

本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

2009年度～2010年度 売上高推移



単位: 億円



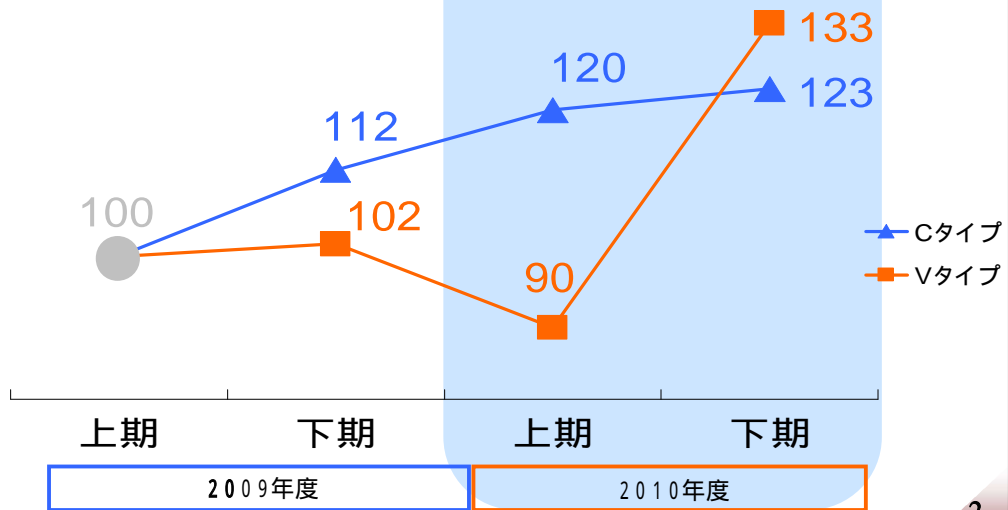
Your Probing Partner

1

2009年度～2010年度 C、Vタイプ売上高推移



2009年度上期を100とした場合



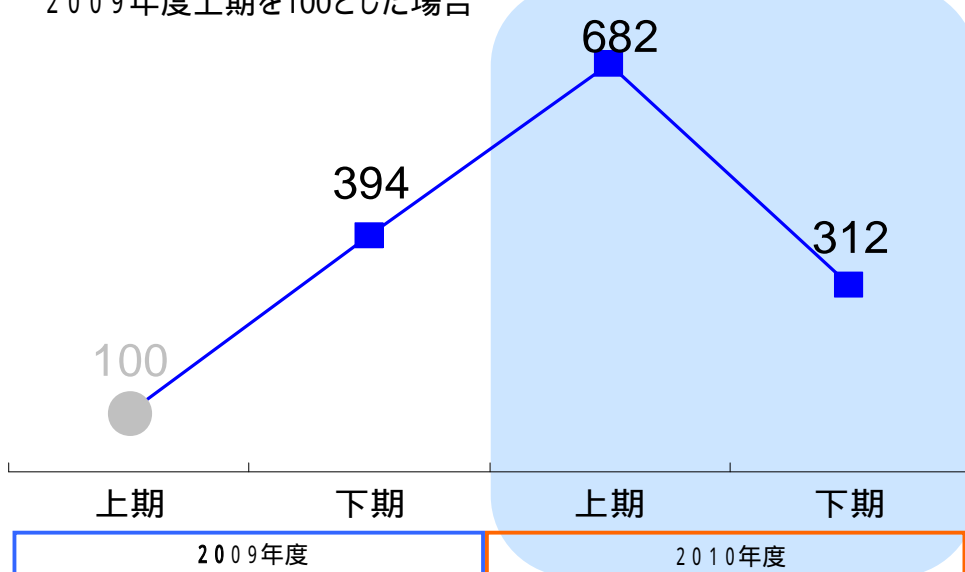
Your Probing Partner

2

2009年度～2010年度 MC 売上高推移 (単体)



2009年度上期を100とした場合



Your Probing Partner

3

2010年度結果



単位:億円

	2009年度 実績	2010年度 実績
売上高	89.2	108.3
営業利益 率(%)	7.6 -	6.2 5.8
経常利益 率(%)	7.3 -	5.5 5.1
当期純利益 率(%)	7.7 -	3.1 2.9

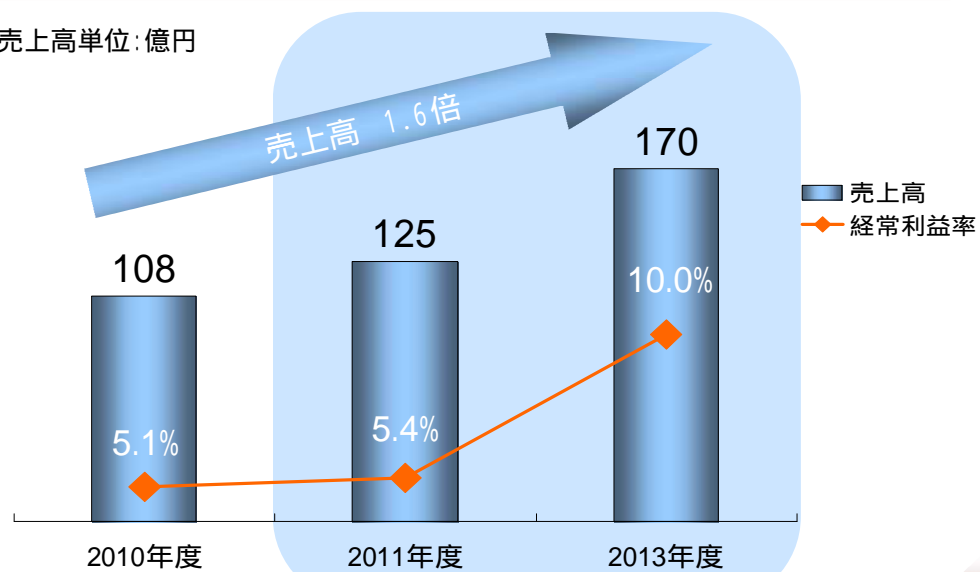
Your Probing Partner

4

中期計画



売上高単位:億円



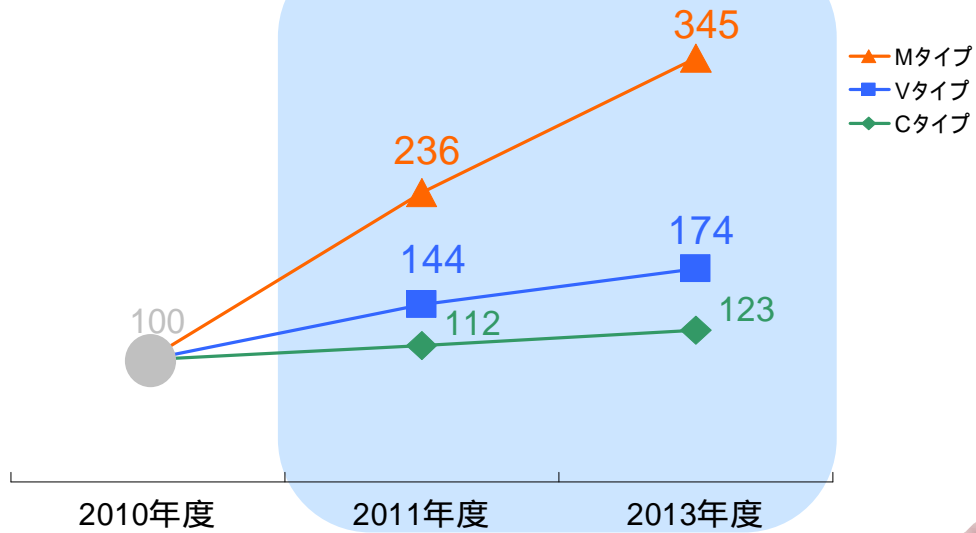
Your Probing Partner

5

中期計画

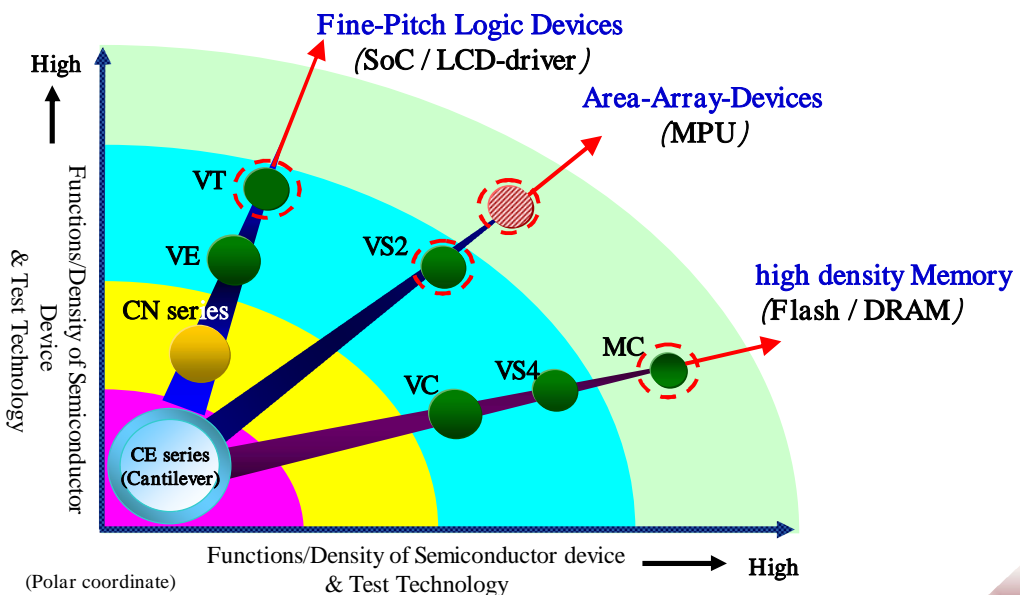


2010年度を100とした場合



Your Probing Partner

製品ラインナップ

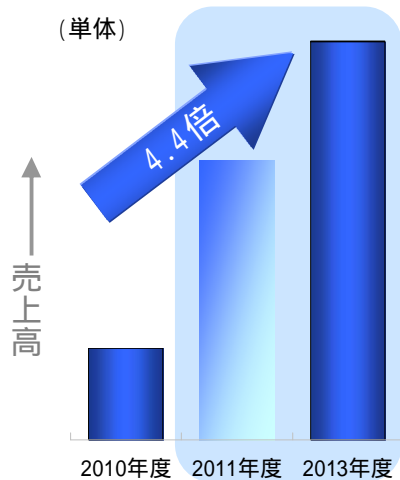


Your Probing Partner

V T 戦略



ハイエンドSoC向け主力製品



市場

SoC

強み

狭ピッチ、多数個同時測定
良好な電気的特性

課題

市場拡大
国内SoCビジネスの動向

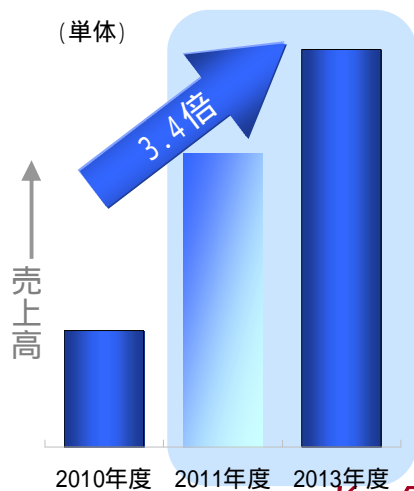
Your Probing Partner

8

V S 2 戦略



実績と経験を活かして次のステージへ



市場

スマートフォンMPU向け
コブラ市場への参入

強み

フリップチップ向けコンタクトの
実績とノウハウ

課題

多ピン化対応
海外サポート力の強化

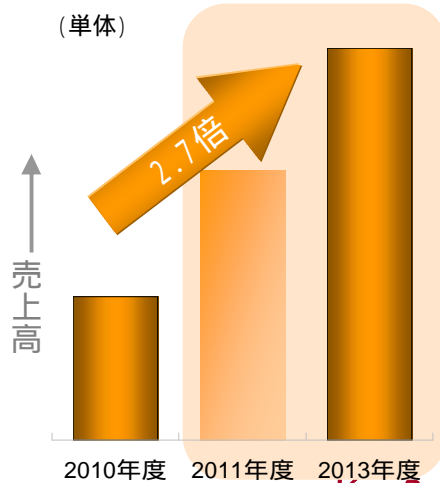
Your Probing Partner

9

MC戦略



JEMの主力製品に成長させる



市場
半導体メモリー

強み
自社製MEMSプローブ
現地サポート力

課題
新規顧客開拓
新市場への参入

Your Probing Partner

10

次世代に向けた製品開発



1. NOR、DRAM向MCの開発
2. 次世代ロジック(エリアアレイ)向PCの開発
3. 次世代微少電流、高周波向け(10GHz)向PCの開発

Your Probing Partner

11

次世代を見据えた要素技術開発



1. 既存製品の狭ピッチ化等の
性能向上
2. 革新的原価低減の為の
要素技術開発(部材の内製化)

Your Probing Partner

12

海外エリア別中期計画



1. アメリカ
 - ・NAND市場の拡大
 - ・次世代ロジック顧客の開拓
2. 韓国
 - ・メモリー市場の拡大
 - ・SoC市場における拡大
3. 台湾
 - ・Vタイプビジネスの拡大
 - ・合金針の優位性を武器に新顧客の開拓

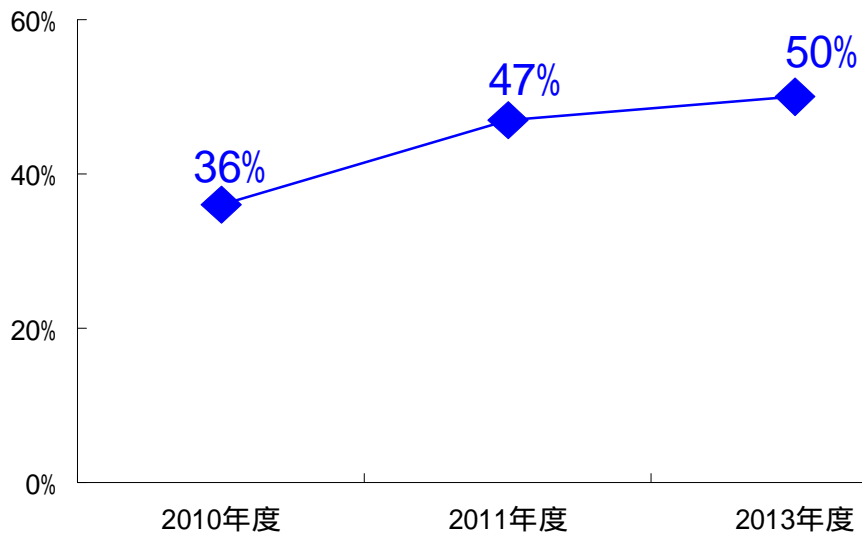
Your Probing Partner

13

海外戦略



海外比率推移と目標



Your Probing Partner

震災の影響



1. 材料部品の調達

「震災3.11プロジェクト」発足

サプライヤーとのキメ細かい調整

顧客要求に対応 キメ細かい生産調整

2ヶ月・・・ほぼ平常どおり

結果として、この為の受注減は、
ほとんど無し

Your Probing Partner

15

震災の影響



2. プラス面

- ・内部加工の拡大
- ・部品の内製化プロジェクト
- ・顧客支援による信頼向上

3. マイナス面

- ・半導体メーカーの直接、間接のダメージ

Your Probing Partner

16

2011年度見通し



単位:億円

	2010年度 実績	2011年度予想		
		上期	下期	通期
売上高	108.3	57.0	68.0	125.0
営業利益	6.2	2.0	5.5	7.5
経常利益	5.5	2.0	4.7	6.7
当期純利益	3.1	0.9	4.3	3.4

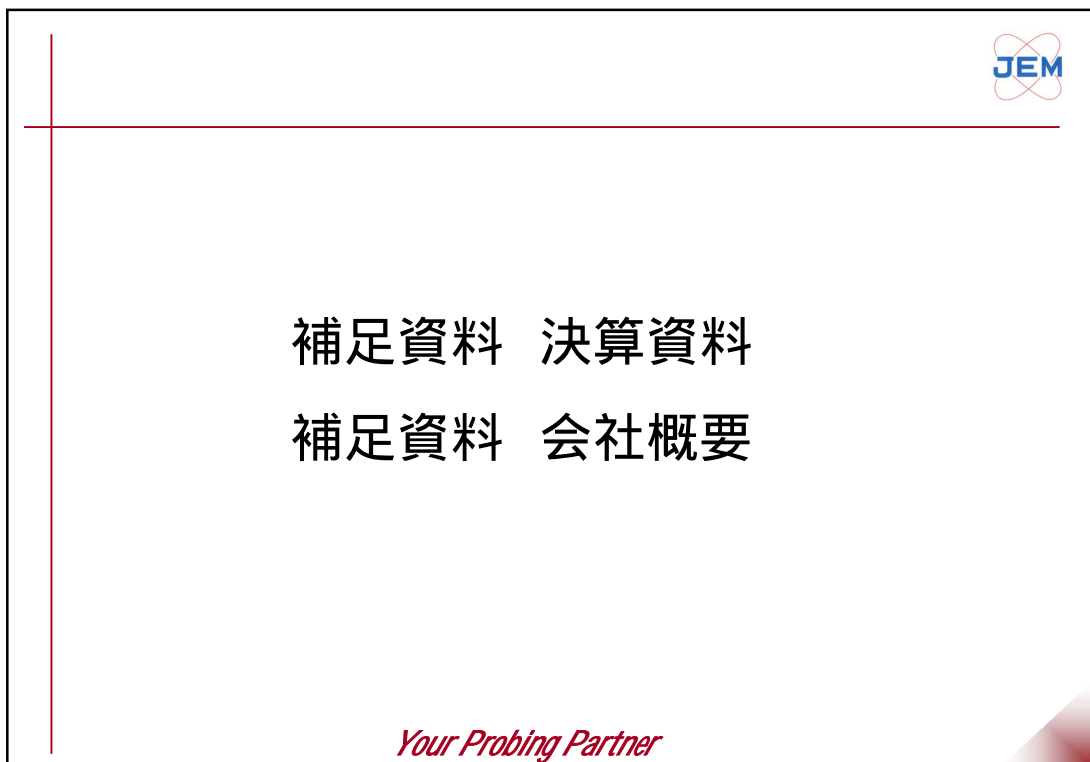
配当は安定配当として年間10円(中間5円、期末5円)を予定

Your Probing Partner



ありがとうございました

<http://www.jem-net.co.jp/>



補足資料 決算資料
補足資料 会社概要

Your Probing Partner

連結貸借対照表

補足資料



単位:百万円

	2009年度		2010年度	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
資産の部				
流動資産	12,346	76.1	10,843	74.8
有形固定資産	2,839	17.5	2,850	19.7
無形固定資産	342	2.1	243	1.7
投資その他	695	4.3	559	3.9
資産合計	16,223	100.0	14,498	100.0
負債の部				
流動負債	5,198	32.0	3,753	25.9
固定負債	1,863	11.5	1,570	10.8
負債合計	7,062	43.5	5,323	36.7
純資産の部				
株主資本	9,722	59.9	9,934	68.5
その他の包括利益累計額合計	560	3.5	760	5.2
純資産合計	9,161	56.5	9,174	63.3
負債純資産合計	16,223	100	14,498	100

Your Probing Partner

連結損益計算書

補足資料



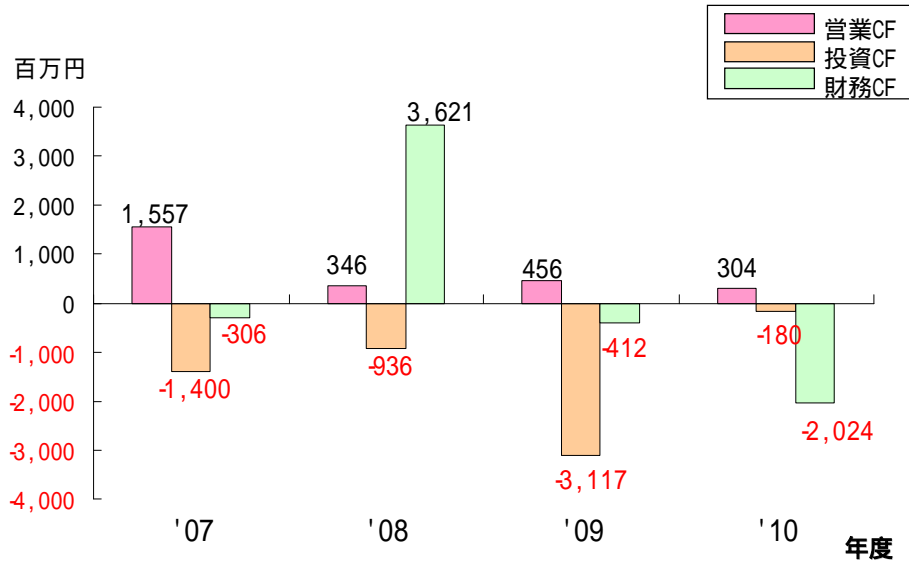
単位:百万円

	2009年度		2010年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
売上高	8,929	100.0	10,836	100.0
売上総利益	1,870	20.9	3,120	28.8
販管費	2,638	29.5	2,491	23.0
営業利益又は営業損失	767	-	629	5.8
営業外収益	122	1.4	66	0.6
営業外費用	86	1	144	1.3
経常利益又は経常損失	730	-	551	5.1
特別利益	-	-	-	-
特別損失	-	-	99	0.9
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失	730	-	451	4.2
法人税等合計	46	0.5	133	1.2
当期純利益	776	-	318	2.9

Your Probing Partner

キャッシュ・フロー

補足資料



Your Probing Partner

投資、配当

補足資料



単位: 億円

	09年度	10年度	11年度 投資計画(予想)
開発費	10.0	8.0	8.6
設備投資	5.2	8.1	8.4
減価償却	8.7	7.9	9.2

単位: 円

	09年度	10年度	11年度 配当予想
配当	年間10 (中間5、期末5)	年間10 (中間5、期末5)	年間10 (中間5、期末5)

Your Probing Partner

23

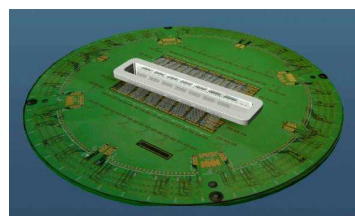
会社概要

補足資料



会社名 日本電子材料株式会社
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS
CORPORATION

設立 1960年4月
資本金 9億8千万円
上場 東証1部 (証券コード6855)
子会社等 国内1 海外6
従業員 約891名(連結)
事業内容 半導体検査用部品(プローブカード)等

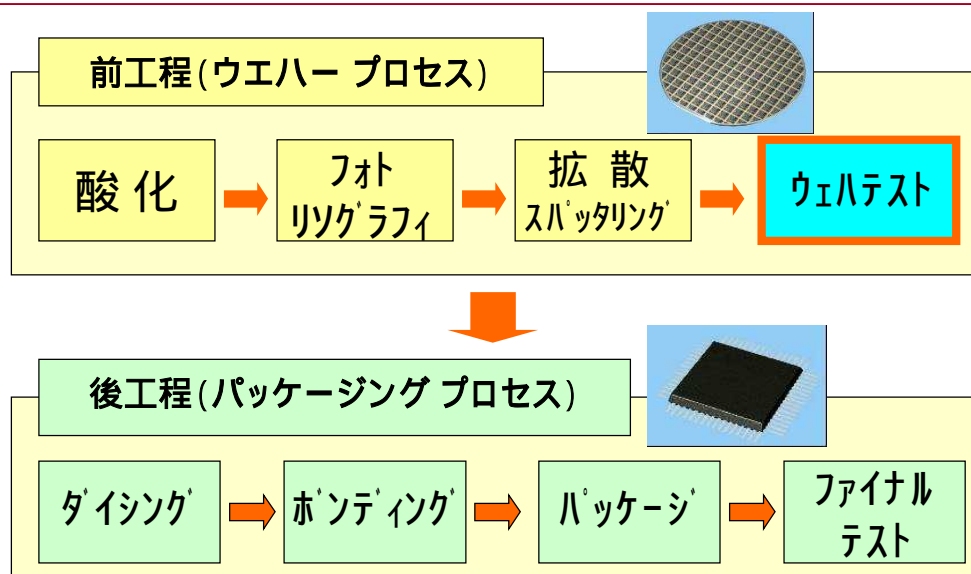


Your Probing Partner

24

半導体の製造工程

補足資料



Your Probing Partner

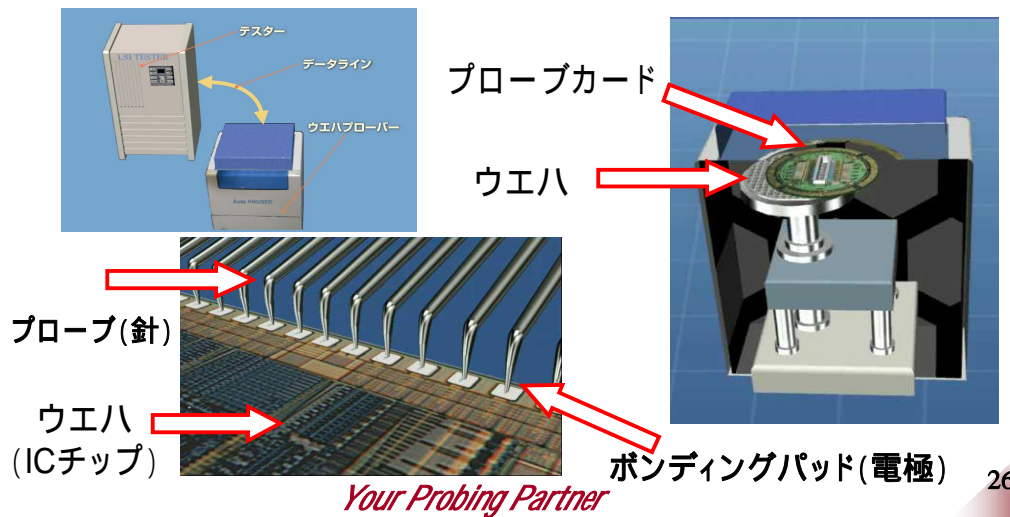
25

プローブカードとは

補足資料



半導体のウエハテスト工程で、テスターからの電気信号をICチップに伝える役割を果たし、半導体製造には必要不可欠な製品です



26

国内拠点

補足資料



尼崎(本社)

- ・管理部門統括
- ・国内営業統括
- ・海外統括
- ・MEMS統括



熊本(事業所)

- ・第一生産統括
- ・第二生産統括
- ・品質統括
- ・製品技術統括

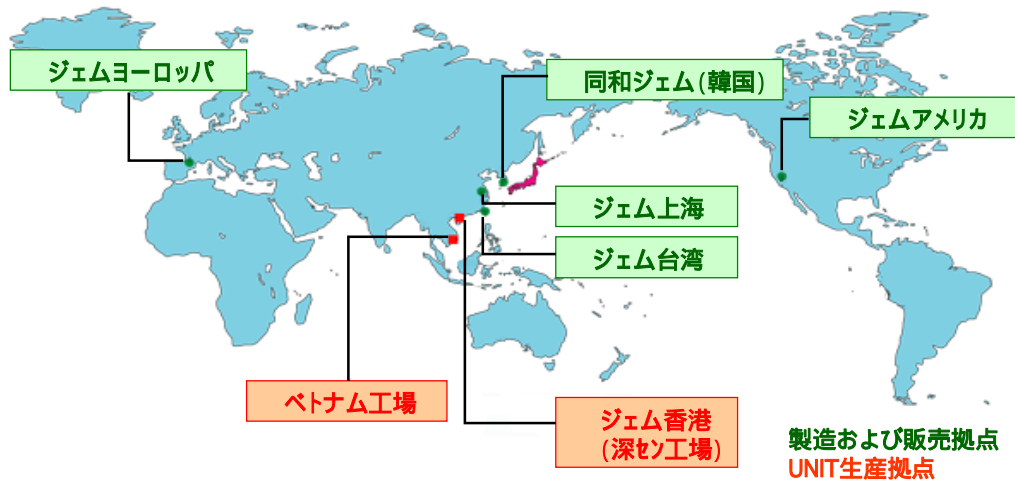


Your Probing Partner

27

海外拠点

補足資料



Your Probing Partner



JEM

Your Probing Partner

Your Probing Partner